

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称	长城基金管理有限公司；上海乘舟投资管理有限公司；深圳市惠通基金管理有限公司；东兴基金管理有限公司；上海煜德投资管理中心(有限合伙)；申万宏源证券有限公司；中海基金管理有限公司；中证鹏元资信评估股份有限公司；北京新建创业投资有限公司；长城财富保险资产管理股份有限公司；北京京管泰富基金管理有限责任公司；首创证券股份有限公司；亚太财产保险有限公司；平安证券股份有限公司；建信养老金管理有限责任公司；泓德基金管理有限公司；九泰基金管理有限公司；民生理财有限责任公司；光大永明人寿保险有限公司；汇泉基金管理有限公司；大家资产管理有限责任公司；南方基金管理股份有限公司；西南证券股份有限公司；朱雀基金管理有限公司；浙商证券股份有限公司；中信建投证券股份有限公司；深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司；招商证券资产管理有限公司；国泰基金管理有限公司；长信基金管理有限责任公司；；太平基金管理有限公司；天弘基金管理有限公司；恒越基金管理有限公司；永赢基金管理有限公司；中信证券股份有限公司；江苏第五公理投资管理有限公司；上海弥远投资管理有限公司；上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)；东方证券股份有限公司；华创证券有限责任公司；中海基金管理有限公司；万家基金管理有限公司；野村东方国际证券有限公司；上海苓茏投资管理有限公司；工银安盛资产管理有限公司；交银康联人寿保险有限公司；中银基金管理有限公司；

	上海榕湖投资管理有限公司；长安基金管理有限公司；中银资产管理有限公司；上海观火投研咨询管理有限公司；广东比邻投资基金管理有限公司；汇华理财有限公司；上海汐泰投资管理有限公司；南京证券股份有限公司；富安达基金管理有限公司；华富基金管理有限公司；平安基金管理有限公司；国联安基金管理有限公司；华泰保兴基金管理有限公司；北京市星石投资管理有限公司；东吴基金管理有限公司；财通证券资产管理有限公司；国投瑞银基金管理有限公司；浦银安盛基金管理有限公司；泓德基金管理有限公司；建信基金管理有限责任公司；中再资产管理股份有限公司；华泰证券股份有限公司；泓德基金管理有限公司；平安基金管理有限公司；上海运舟私募基金管理有限公司；新华基金管理股份有限公司；大成基金管理有限公司
时间	2024年5月7日-6月5日
地点	公司会议室等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘雁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、随着国家大基金三期的成立，集成电路产业持续利好，公司对各业务层面后续业绩展望是如何的？具体规划是怎样的？</p> <p>国家集成电路产业投资基金已经成为引领国产芯片产业崛起的强大引擎，大基金三期的成立展现了其对国产芯片产业长期发展的坚定信心。</p> <p>信号链领域，公司在传感器业务成功实现了从0到1的营收突破，未来其增速会非常快。这主要得益于产品的快速量产进程。目前，表冠旋钮检测芯片、TWS 入耳检测芯片以及窄缝三合一芯片等产品均已实现量产，并预计在今年年底前将上述产品的系列化芯片全面推向市场。公司在手机端规划的 OLED 屏下传感、全光谱检测传感、dToF 传感等产品，预计将在下半年开始进入客户送样测试阶段。另一方面，公司布局的传感器应用领域广泛，市场需求巨大。无论是在智能手机、智能手表、TWS、笔电和 LCD 大屏等消费电子产品中，还是在自动驾驶、机器人、智慧工业等 AI 场景终端领域，一旦实现规模化销售，其潜在的市场</p>

规模将极为可观，有望为公司带来持续稳定的业绩增长。

其次，无线充电在 2024 年也会保持增长。得益于老客户终端需求数量的增加，以及最近新客户的拓展，尤其是海外客户，这些终端需求的增长将促进无线充电生态的进一步建立与业绩增长。另外，为了协同无线充电，我们也加强了有线充电的技术储备，这个市场也比较大，公司希望明年这些产品能够进入量产给公司带来增益。

再次，LED 业务已经相对成熟，为进一步拓宽业务领域，公司正积极开拓汽车电子照明市场，目前已有部分产品成功实现量产并在几家大型汽车制造商中使用。公司计划在明年完成所有照明驱动产品的研发，为后续增长奠定基础。

2、在新能源汽车大力发展和汽车芯片本土化进程中，请系统介绍下公司的车规芯片业务及最新进展情况？

公司在汽车电子领域布局了多门类车规产品，主要规划之一将已经量产的消费级、工业级 IP 转为车规级工艺并快速进入车规领域。汽车电子的导入周期、认证周期相对较长，从研发角度看整体进展符合预期，客户覆盖业内知名汽车品牌厂商。

其中，车载无线充电发射端芯片已通过车规认证，车规级 100W 发射端芯片已启动研发立项；在车灯照明领域，如单路、三路以及 24 路的 LED 恒流驱动，相关产品正陆续导入业内知名车企供应链中；CAN SBC 即将进入车规认证和送样阶段；CAN PHY 系列的研发已经启动；此外，公司还规划了雨量检测和雾气检测光学传感器等新品。

公司将持续优化产品矩阵并对产品不同的使用场景进行探索，不断提升公司的服务能力，为股东创造长期投资价值，具体请以其官方发布的信息为准。

3、请问公司今年对传感业务的产品结构规划是如何的？另外，对新进入赛道的企业来说，技术难点或壁垒有哪些？

首先，公司已完成信号链光学传感器的多种类布局，包括环

境光传感、接近传感、皮肤识别传感、环境与接近传感、光学位移传感等。在智能手机端，公司进一步布局了 OLED 屏下光传感器以及辅助影像增强的多光谱检测传感器。在智能手表端，公司推出应用于智能手表的业内首款集成了旋转和按压检测功能的高精度光学追踪传感器。在 TWS 耳机端，公司在入耳检测传感的基础上迭代皮肤检测算法，推出皮肤检测接近传感器。此外，公司还在拓展 dToF 和 iToF 等摄像头距离检测传感器、3D 人脸识别方面的传感器以及用于汽车的雨量检测和雾气检测光学传感器，希望对光传感相关的产品实现系列化，为客户提供手机端和配件的一揽子解决方案。

其次，光学传感器市场，尤其是高附加值市场的国产化率较低的主要原因在于其复杂的系统结构和较高的技术门槛。简单来说，光学传感器是一个完整的光学和数据采集系统，集成了光学、工艺、模拟、数字系统和图像处理等多领域的技术。该系统通过深度融合光路设计、封装设计、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、光电探测器（PD）工艺、镀膜技术以及数模混合 SoC 芯片等跨学科要素，实现了高度集成和系统级的应用。此外，其封装生产过程相对复杂，需要确保光学系统在封装过程中不受污染；测试验证方面也需要进行多重定制化的电学、光学测试，鉴于此，其技术壁垒较高，国内品牌较为稀缺，对于芯片设计企业来讲这既是机遇也是挑战。

4、公司如何应对无线充电生态的多元化发展趋势和竞争格局？

首先，无线充电技术已广泛应用于智能手机的高端机型中，尤其在折叠屏手机、AI 手机以及旗舰手机等细分领域，其普及程度不断提升，且这一趋势将继续保持。与此同时，随着无线充电生态的拓展和大众充电习惯的养成，无线充电技术正逐步从高端市场向低端市场延申，众多厂商亦在积极探索将无线充电技术用于中低端手机的可能性。

针对此，公司提供 5W~100W 的全系列接收端与发射端无线充电产品及其相应解决方案，旨在满足不同领域的应用需求。产

品广泛适用于智能手机、智能手表/手环、蓝牙耳机、平板电脑及其配件、车载无线充电等诸多领域。同时，鉴于无线充电市场下沉的趋势，为更好地满足广大客户的多样化需求，公司特别规划了 30W、50W 及 80W 三个功率梯队的无线充电产品群，旨在为客户提供更多选择，以更精准地满足下沉市场的实际需求。通过这一举措，公司旨在进一步提升客户体验，并巩固公司在无线充电领域的领先地位。

其次，公司计划从以下方面保持企业竞争优势：1) 持续扩大和终端厂家合作范围与深度，拓展客户群，并提升客户粘性和壁垒，针对不同产品进行更细化定制，提供全面和高性价比的解决方案；2) 优化设计，加速迭代，提升芯片性能和功能，力求保持在技术和创新方面的领先；3) 优化生产工艺，提升工艺自研开发能力，在成本和工艺技术上取得领先；4) 率先推出满足工信部最高功率规定的 80W 接收端芯片，公司的无线充电产品从 100W、80W、50W 到配件的整个系列，从发射端到接收端做得非常齐全。

随着无线充电应用的普及以及车载无线充电应用场景建立，无线充电市场呈现持续增长态势，因此竞争在所难免，希望共同推动产业的发展，共同为客户提供更有性价比、更有创新的产品。

5、在新质生产力方面，公司业务是否涉及低空经济，诸如飞行汽车、无人驾驶等领域？那在 AI 赛道是否也有相关布局呢？

低空经济和人工智能作为战略性新兴产业，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及领域多等特点。公司专注于“电源管理+信号链”双驱动产品发展战略，坚持市场导向和技术创新，不断完善产品谱系并对产品不同的使用场景进行探索。

在智能网联汽车发展趋势的引导下，公司布局了多门类车规芯片产品，公司的车载无线充发射芯片以及雨量检测和雾气检测光学传感器等产品可应用于智能座舱，公司布局的接口芯片、CAN SBC 等产品可应用于智能座舱/自动驾驶领域。

	<p>公司已有的 PMIC 和传感器产品可适用于 AI 手机、机器人等 AI 终端场景，同时正在积极推进 DtoF、ItoF 等摄像头距离检测传感器以及 3D 人脸识别传感器的拓展工作，未来将与 AI 视觉算法相结合，从而创造更多 AI 实际应用场景的可能性。公司将密切关注行业动态和新兴市场机遇，推动新质生产力赋能公司发展，积极开拓新领域和新业务，以推动公司整体战略发展方向的深入实施。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 5 日